



2025年 半导体探针卡行业词条报告

头豹分类/制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/电子器件制造/半导体分立器件制造

企业竞争图谱：2025年半导体探针卡 头豹词条报告系列



于利蓉 · 头豹分析师

2025-04-03 © 未经平台授权，禁止转载

行业分类： 制造业/半导体分立器件制造

摘要 半导体探针卡是半导体晶圆测试的硬件，是测试机与待测晶圆的接触媒介，技术壁垒高且资本密集。MEMS探针卡为行业主导产品，市场份额占比高。中国集成电路产业快速发展，半导体制造能力提升，带动探针卡需求增长。未来，半导体技术不断进步，晶圆测试重要性显现，“后摩尔时代”技术发展要求探针卡具备更复杂结构和更高测试要求，推动探针卡行业持续发展。

行业定义

半导体探针卡是一种应用于半导体晶圆测试的硬件，是测试机与待测晶圆的接触媒介。透过探针卡之探针(Probe)与晶圆上的焊垫(Pad)或凸块(Bump)接触后，将电性信号传送到测试机台分析其功能与特性，判别晶粒的好坏，即透过电性量测的方式筛出不良品，减少切割后的不良品进入后段的封装制程，降低IC生产成本的浪费。

行业分类

半导体探针卡基于结构类型，可分为悬臂式探针卡、垂直式探针卡、MEMS探针卡

半导体探针卡基于结构类型的分类

悬臂式探针卡、垂直式探针卡、MEMS探针卡

悬臂式探针卡

悬臂式探针卡可以想象成“吊桥”。它的探针呈悬臂状伸向晶圆，与晶圆表面接触。这类探针卡成本较低，探针相对较粗，通常用于传统模拟芯片、逻辑芯片等需要较大焊垫或凸块的芯片。悬臂式探针卡探针直径较大，针痕也较深，晶圆上的焊垫在多次接触后容易受损。

垂直式探针卡

垂直式探针卡则可以比作“电梯”，探针垂直排列，与晶圆表面垂直接触。这种结构可以容纳更多针脚，适用于焊垫或凸块较小的高端芯片，如手机处理器、GPU等。这类探针卡的针痕较浅，适合反复多次测试，且探针之间的间距可以做到非常小。

MEMS探针卡

MEMS探针卡采用微机电系统技术（Micro-Electrical-MechanicalSystems, MEMS），将探针做到极为精细，适合非常小间距、高针数的测试需求。MEMS探针卡具有高度的自动化和一致性，常用于先进的半导体工艺，例如7nm、5nm的高端处理器或GPU芯片。它像是“微型手术刀”，精度极高，能够在微米级别的空间内进行探针排布。

行业特征

半导体探针卡的行业特征包括技术壁垒高、属于资本密集型行业、MEMS探针卡为行业主导产品。

① 技术壁垒高

探针卡行业属于技术密集型行业。近年来，随着半导体技术的发展，探针卡技术向着超密集间距、多引脚数量、超多测试次数以及超高频测试等方向不断发展。不同芯片的应用领域对晶圆测试的性能、技术指标均具有差异化的要求。而探针卡所需的探针、PCB、空间转接基

板等均系精密部件，尤其是MEMS工艺综合了先进激光技术以及光刻工艺以构建微米尺寸精密部件，相关部件的设计、制造技术均具有很高难度。

② 属于资本密集型行业

例如，MEMS工艺制造探针过程中需要用到光刻机、刻蚀机、电镀设备、研磨机、激光设备等先进且昂贵的设备，前期投入大、投资风险高，需要企业保持较高的营运资金水平。另外，由于半导体技术的不断发展以及探针卡高度定制化的特征，厂商需要持续保持较高研发投入和人才投入以应对不断发展和差异化的测试需求。因此，行业对新进入者具有较高的资金壁垒。

③ MEMS探针卡为行业主导产品

从产品结构来看，探针卡产品主要分为MEMS探针卡、垂直探针卡、悬臂探针卡等。其中，MEMS探针卡是目前行业主导产品，2023年全球半导体探针卡行业中MEMS探针卡市场份额达到60%-70%。垂直探针卡、悬臂探针卡市场份额合计占比较低且呈现下降趋势，2023年分别为14.19%和10.11%。

发展历程

探针卡是晶圆测试中被测芯片和测试机之间的接口，最早的探针卡开发于1969年，被称为Needles/Epoxyring探针卡即悬臂梁式探针卡，至今仍被使用着，20世纪70年代，刀片式探针卡被开发应用于中低密度的测试探针数测试中；20世纪80年代，薄膜式探针卡开始开发应用，至21世纪，半导体探针卡市场参与者众多，行业竞争激烈，中国半导体探针卡企业不断发展。

萌芽期 · 1969-01-01~1970-01-01

第一代探卡-环氧树脂环/悬臂梁针型探卡（Epoxy Ring/Cantilever Needle Probe Card）产生于1969年，由IBM公司研发并运用于半导体晶圆测试中，这种探针卡以环氧树脂环技术为基础，将数十根至数百根的测试探针以手工方式安置在探针卡上，用于测试芯片的焊区。

传统型探卡采用手工方法制备和装配，微悬臂梁形探针通过环氧树脂环固定在PCB板上。

启动期 · 1971-01-01~1999-01-01

20世纪70年代，刀片式探针卡被开发出来，应用于中低密度的测试探针数测试中；20世纪80年代，薄膜式探针卡开始开发应用。刀片式探针卡、薄膜式探针卡进入市场。

高速发展期 · 2000-01-01~2020-01-01

1988年，微光刻技术制作探针卡被引入配合测试芯片焊区的位置；随着探针卡测试技术的不断成熟和芯片测试要求的逐步提高，测试探针排列方式便相应固定为水平式与垂直式，垂直式探针卡、微弹簧式和微机电式探针卡等新型探针卡不断涌现；2015年，强一股份成立；2017年，微针半导体成立。多类型探针卡涌现市场，行业参与者不断增加。

成熟期 · 2020-01-01~至今

2021年，思达科技宣布推出牡羊座Aries Optima MEMS探针卡，是全球首款应用在大量制造的微间距大电流MEMS垂直探针卡。2023年，强一股份位列全球前十大半导体探针卡厂商之一，冲刺IPO。半导体探针卡市场参与者众多，行业竞争激烈，中国半导体探针卡企业不断发展。

产业链分析

半导体探针卡产业链的发展现状

半导体探针卡行业产业链上游为原材料；产业链中游为半导体探针卡的生产制造环节；产业链下游为应用环节。

半导体探针卡行业产业链主要有以下核心研究观点：

中国半导体行业起步相对较晚，半导体探针卡行业由国外厂商主导，国产替代刻不容缓。产品中市场份额最大的是MEMS探针卡，其次是垂直探针卡。

中国半导体产业起步较晚，发展较快，半导体探针卡行业均由境外厂商主导，多年来全球前十大探针卡厂商均为国外企业，2023年半导体探针卡市占率前十企业仅中国强一股份排进前十，市占率约2.25%。从产品结构来看，探针卡产品主要分为MEMS探针卡、垂直探针卡、悬臂探针卡等。其中，MEMS探针卡具有精密度高、测试效率高、耐用性强、稳定性好等优势，是目前行业主导产品。

产业链上游环节分析

半导体探针卡上游环节

生产制造端

上游主要为探针卡原材料、设备，主要包括空间转接基板、PCB、探针头及MEMS探针制造材料、机械结构部件、探针、线材及元器件等。

上游厂商

苏州和林微纳科技股份有限公司

上游分析

上游主要为探针卡原材料、设备等。其中PCB价格受数量、技术参数、材料、工艺以及交期等因素的直接影响存在较大差异，MEMS探针原材进口依赖度较大。

半导体探针卡上游主要为探针卡原材料、设备等。其中原材料主要包括空间转接基板、PCB、探针头及MEMS探针制造材料、机械结构部件、探针、线材及元器件等。PCB方面，由于探针卡所需的PCB具有定制化、加工复杂、技术门槛高的特点，一般需要根据探针卡方案进行定制，目前中国境内外均存在相关供应商，但由于探针卡高复杂、高精密、小批量的特征，满足探针卡要求以及可以实现快速交付的高端PCB供应商整体较少，不同PCB价格受数量、技术参数、材料、工艺以及交期等因素的直接影响存在较大差异。在MEMS探针制造材料、探针、空间转接基板、研发设备、MEMS探针生产设备等方面，能够满足要求的仍以中国境外供应商或其在中国境内分支机构为主。

产业链中游环节分析

半导体探针卡中游环节



品牌端

半导体探针卡的生产制造环节

中游厂商

浙江微针半导体有限公司 强一半导体(苏州)股份有限公司 FormFactor Technoprobe MJC 旺矽科技 JEM
KoreaInstrumentCO.,Ltd. 思达科技股份有限公司 NidecSVProbePte.Ltd. Will-TechnologyCO.,Ltd.

中游分析

半导体探针卡行业由国外厂商主导，国产替代刻不容缓。产品中市场份额最大的是MEMS探针卡，其次是垂直探针卡。

从2023年排名前十的半导体探针卡厂商来看，分别为美国FormFactor（市占率23.52%）、意大利Technoprobe（市占率18.62%）、日本MJC（市占率12.13%）、中国台湾旺矽科技（市占率6.47%）、日本JEM（市占率5.63%）、韩国KoreaInstrumentCO.,Ltd.（市占率2.99%）、中国台湾思达科技股份有限公司（市占率2.62%）、新加坡NidecSVProbePte.Ltd.（市占率2.48%）、中国强一股份（市占率2.25%）、韩国Will-TechnologyCO.,Ltd.（市占率2.09%）。**2023年中国半导体探针卡市场规模超过全球的10%，但结合强一股份2023年收入规模推算中国国产探针卡厂商全球市场份额占比不足5%，国产替代空间广阔。**从全球市场来看，MEMS探针卡市场份额近年持续达到60%-70%。其次是垂直探针卡，2023年市场份额占比为14.19%，垂直探针卡主要应用于性能相对较强的芯片晶圆测试，其市场规模较大。悬臂探针卡2023年市场份额占比仅为10.11%，主要系其应用于对性能要求不高、设计和结构相对简单的芯片晶圆测试，因此悬臂探针卡一般装配的探针数较小，且单针价格相对经济。

产业链下游环节分析

半导体探针卡下游环节



渠道端及终端客户

应用领域，主要面向半导体产业中游半导体设计与制造

渠道端

展讯通信 普冉股份 中兴微 复旦微电 兆易创新 紫光国微 紫光同创 聚辰股份 晶晨股份 中电华大 龙芯中科
紫光青藤 卓胜微 韦尔股份 地平线 华虹集团 长电科技 通富微电

下游分析

半导体探针卡的需求可以涵盖半导体领域IDM模式、垂直分工模式下各类参与者，中国境内下游客户以芯片设计厂商为主。

半导体探针卡产品主要面向半导体产业中游半导体设计与制造。从经营模式角度，根据厂商是否具备产业链垂直整合制造能力，半导体产业可以分为IDM模式、垂直分工模式。IDM模式即垂直整合制造模式，是指半导体厂商能够独立完成芯片设计、晶圆制造和封装测试

等全部业务环节。垂直分工模式是指半导体厂商根据产业分工以及自身技术特长聚焦一项或多项具体业务环节，如芯片设计、晶圆代工或封装测试等。在IDM模式下，厂商一般自主完成晶圆测试，但因IDM厂商专注于半导体工艺、产业细分领域高度分工以及探针卡的高定制化特征等，IDM厂商具有采购探针卡的需求。在垂直分工模式下，晶圆测试的最大需求来自芯片设计厂商，由于其专注于产品设计，无自主晶圆制造能力及封装测试产线，需通过委托晶圆代工商、封装测试厂商等第三方完成相应测试，主要通过自身或前述第三方采购晶圆测试所需的探针卡。因此，探针卡的需求可以涵盖IDM模式、垂直分工模式下各类参与者，但由于各地区半导体产业发展情况不同，探针卡厂商下游客户存在一定差异。在中国，由于资本投资、技术水平以及产业分工等因素，芯片设计厂商目前数量居多，探针卡厂商境内客户群体以芯片设计厂商为主。境外来看，欧美地区芯片设计、IDM厂商较为领先，韩国IDM厂商较为领先，中国台湾晶圆代工、封装测试厂商较为领先，探针卡厂商前述地区客户以当地相对领先的厂商为主。

| 行业规模

半导体探针卡行业规模的概况

2019年—2024年，半导体探针卡行业市场规模由1.76亿美元增长至2.15亿美元，期间年复合增长率4.08%。预计2025年—2029年，半导体探针卡行业市场规模由2.23亿美元增长至2.58亿美元，期间年复合增长率3.71%。

半导体探针卡行业市场规模历史变化的原因如下：

中国集成电路产业快速发展，半导体制造能力不断提升，直接带动探针卡需求市场的发展。

自2005年以来，中国即成为全球最大的半导体消费国，2022年以来中国半导体市场规模受短期需求波动影响存在增速放缓，但长期增长具有较强确定性。据强一半导体招股书指出，中国集成电路产业市场规模将于2027年达到1,990亿美元，2023-2026年，全球待建晶圆厂数量将达60余个，其中中国待建晶圆厂约为21个，占比约30%。中国半导体制造能力不断提高，半导体制造规模占半导体规模的比例不断提升，由2020年的16.58%增长至2022年的18.29%，并将于2027年达到26.63%；另一方面，中国自主半导体制造渗透率进一步增加，由2020年的34.30%增加至2022年的50.67%。中国集成电路产业快速发展，半导体制造能力不断提升，直接带动探针卡需求市场的发展。

半导体探针卡行业市场规模未来变化的原因主要包括：

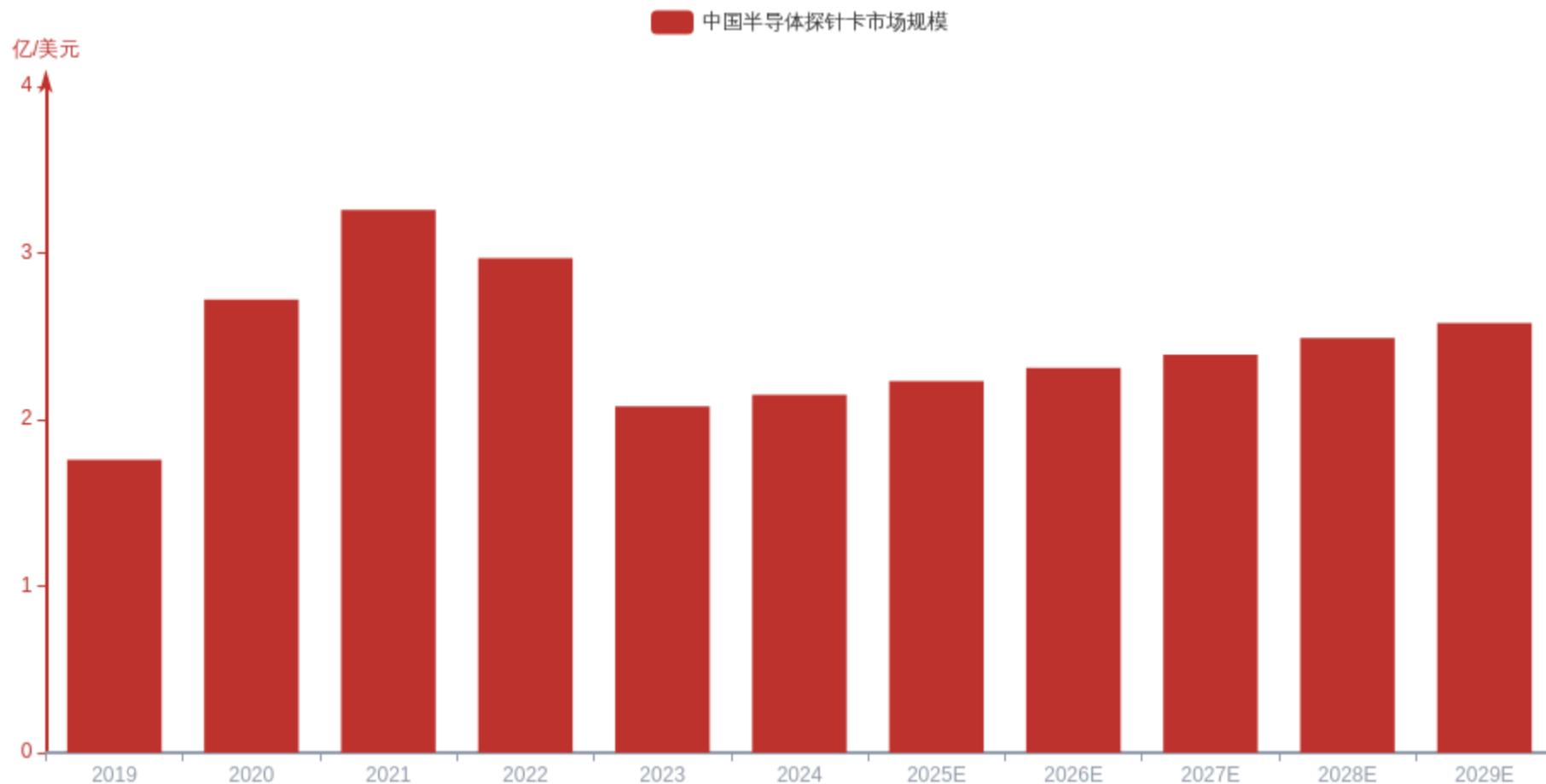
半导体技术不断发展，晶圆测试重要性进一步显现。

在半导体制程方面，“摩尔定律”认为半导体上可容纳元器件的数目，约每隔18-24个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。长期以来，“摩尔定律”一直引领半导体制程技术的发展与进步。“摩尔定律”下，半导体的制程越先进，芯片单位面积能够容纳的晶体管数量越多，性能越强大，功耗也越低。但每代制程开发及制造成本呈指数级提升，导致封装阶段的要求也愈加严苛。随着芯片制程开发难度的加大，以及高端制程制造成本的指数级提升，半导体制造行业步入“后摩尔时代”。“后摩尔时代”半导体技术发展存在两个主要技术方向：SoC和SiP。SoC是从设计和晶圆制造角度出发，将系统所需的组件和功能集成到一枚芯片上，核心系通过设计和制造将数个不同功能的芯片经同样制程集成于单一芯片上；SiP则是从封装角度出发，将不同功能的芯片和元器件集成到一个封装体内，核心系通过封装将不同制程的芯片封装在一个系统内。两种技术的发展使得半导体产品结构愈加复杂化，封装环节的成本显著提升，从而要求晶圆测试探针卡装配更多探针、具备更密集的排针以及更复杂的结构以满足更为严苛的测试要求。

半导体探针卡行业规模



中国半导体探针卡行业规模



数据来源: 强一半导体招股书

政策梳理

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《产业结构调整指导目录(2024年本)》	国家发改委	2023-12-01	6
政策内容	集成电路线宽小于0.5微米(含)的化合物集成电路生产,和球栅阵列封装(BGA)、插针网格阵列封装(PGA)、芯片规模封装(CSP)、多芯片封装(MCM)、栅格阵列封装(LGA)、系统级封装(SIP)、倒装封装(FC)、晶圆级封装(WLP)等列为鼓励类产业。			
政策解读	《产业结构调整指导目录(2024年本)》明确鼓励集成电路产业链相关企业的发展,对集成电路领域封装测试相关电路装备及关键零部件制造企业发展具有重大指导意义。			
政策性质	指导类			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》	工业和信息化部、财政部	2023-08-01	6
政策内容	落实集成电路企业增值税加计抵减政策,协调解决企业在享受优惠政策中的问题。着力提升芯片供给能力,积极协调芯片企业与应用企业的对接交流。面向数字经济等发展需求,优化集成电路、新型显示等产业布局并提升高端供给水平,增强材料、设备及零配件等配套能力。			
政策解读	《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》明确指出要有序推动集成电路等重点领域重大项目开工建设,加快关键材料设备、工艺薄弱环节突破,利于集成电路产业链国产薄弱领域企业的发展。			
政策性质	指导类			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》	中共中央、国务院	2022-12-01	6
政策内容	壮大战略性新兴产业。深入推进国家战略性新兴产业集群发展，建设国家级战略性新兴产业基地。全面提升信息技术产业核心竞争力，推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用。			
政策解读	《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》提出要加快发展新产业新产品，其中包括重点推进集成电路这一国家战略性新兴产业。			
政策性质	指导类			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《“十四五”数字经济发展规划》	国务院	2022-01-01	6
政策内容	着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。实施产业链强链补链行动，加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新，提升产业链关键环节竞争力，完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。			
政策解读	《“十四五”数字经济发展规划》指出到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效。			
政策性质	指导类			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划 和2035年远景目标纲要》	国务院	2021-03-01	6
政策内容	在事关国家安全和发展全局的基础核心领域，制定实施战略性科学计划和科学工程。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目			
政策解读	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划 和2035年远景目标纲要》指出集成电路领域要加强集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破，先进存储技术升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展。			
政策性质	指导类			

竞争格局

半导体探针卡竞争格局概况

半导体探针卡行业呈现以下竞争格局，第一梯队有：FormFactor、Technoprobe、MJC、旺矽科技、JEM；第二梯队有：NidecSVProbePte.Ltd.、KoreaInstrumentCO.,Ltd.、Will-TechnologyCO.,Ltd.、思达科技股份有限公司、SynergieCADGroupSAS、TSECO.,Ltd等；第三梯队有强一半导体等。

半导体探针卡行业竞争格局的历史原因

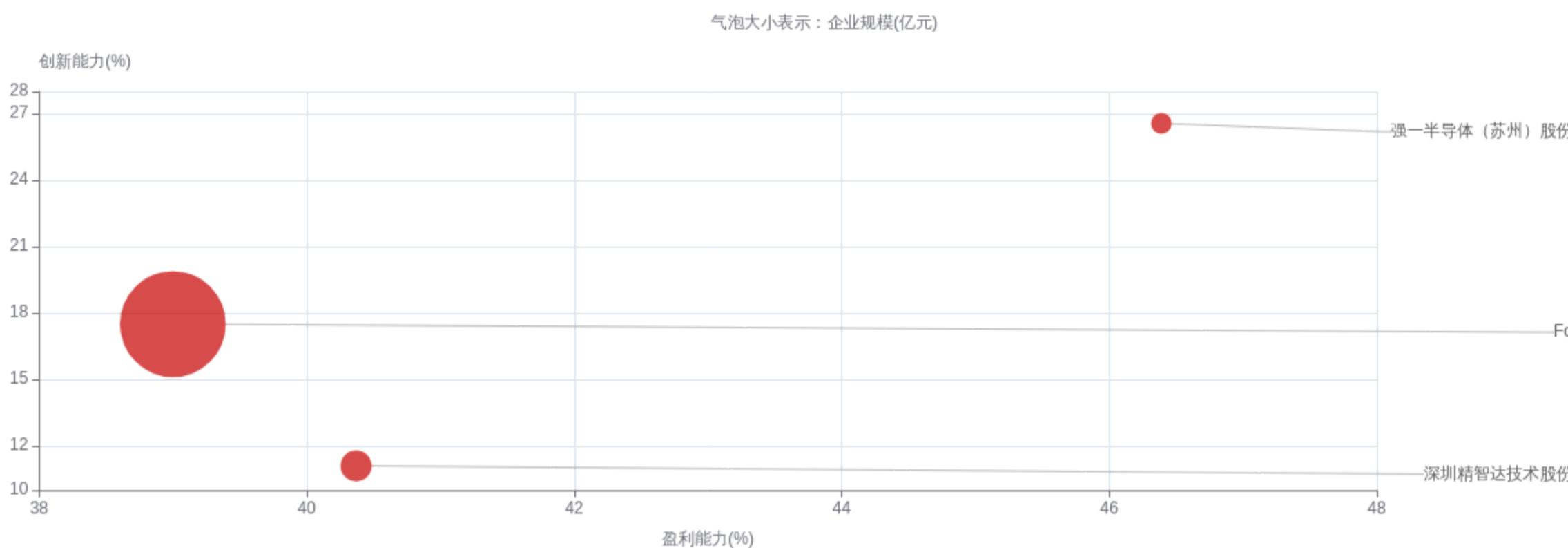
国外企业成立时间较早，进入市场较高，具有先发优势，具有以探针卡为中心的综合化服务能力。

例如FormFactor成立于1993年，总部位于美国，于2003年在美国纳斯达克上市，多年来稳居全球半导体探针卡行业市场第一的位置。FormFactor已形成提供探针卡为主并可提供探针台、工程探针以及计量设备等产品的综合服务能力，主要客户为英特尔、海力士、台积电以及三星等。2023财年，FormFactor营业收入为6.63亿美元，净利润为0.82亿美元。MJC成立于1970年，总部位于日本，于2013年在东京证券交易所上市。MJC主要业务为探针卡和测试设备，主要客户为三星、美光等。2023财年，MJC营业收入为382.92亿日元，净利润为41.27亿日元。旺矽科技成立于1995年，总部位于中国台湾，于2003年在中国台湾证券交易所上柜。旺矽科技致力于提供探针卡测试方案、LED及光电测试解决方案，主要服务中国台湾地区客户。2023财年，旺矽科技营业收入为81.47亿新台币，净利润为13.10亿新台币。

半导体探针卡行业竞争格局未来变化原因

国际政治环境推动和中国政策利好双重驱动中国半导体产业链国产替代进程加速。

近年来，美国对中国半导体产业的限制持续加剧。2017年1月，美国总统科学技术咨询委员会发布《确保美国半导体的领导地位》，宣称中国的半导体发展对美国构成“威胁”。2022年，美国总统拜登签署《芯片与科学法案》，禁止获得联邦资金的公司在中国大幅增产先进制程芯片，同年10月美国商务部工业与安全局对《出口管理条例》进行修订，进一步限制中国在先进计算、半导体制造领域获得或使用美国产品及技术。2023年1月，美国携日本、荷兰建立半导体设备供应联盟，进一步管制半导体生产设备对中国的供应；当年10月美国商务部工业与安全局更新了对先进计算集成电路、半导体制造设备以及支持超级计算应用和最终用途的物项向包括中国等国家的出口管制措施。2024年12月，美国商务部工业与安全局将140个中国实体列入“实体清单”，主要为国产半导体制造、设备厂商；同时新增了对HBM的相关限制和多类高端设备的管制。在全球主要国家均不同程度重视自身半导体供应链安全性以及美国等持续对中国半导体产业进行限制的背景下，中国半导体产业国产替代迫在眉睫。因此，国家出台一系列产业政策，旨在突破半导体各关键“卡脖子”环节、提升中国半导体产品自给率、加强半导体产业链的自主可控性，为行业的发展营造了良好的政策环境和机遇。综上，在国际政治环境推动和国内政策利好的推动下，半导体产业链国产化率有望快速抬升，随着国产化趋势传导，境内半导体参与者对其国产替代供应商的扶持有望持续增加，国产化进程有望进一步加速。



上市公司速览

深圳精智达技术股份有限公司 (688627)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	5.7亿元 >	52.5	36.9

| 企业分析

① 强一 半导体(苏州)股份有限公司

▪ 公司信息

企业状态	存续	注册资本	9716.9418万人民币
企业总部	苏州市	行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
法人	周明	统一社会信用代码	91320594354568613M
企业类型	股份有限公司(港澳台投资、未上市)	成立时间	1440691200000
品牌名称	强一半导体(苏州)股份有限公司	经营范围	研发、加工、生产、销售：半导体产品、集成电路测试设备、计算机软件，并提供相关产品的售后服务和技术服务；半导体芯片、连接器、继电器的销售及售后服务；从事上述产品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

▪ 融资信息

融资时间	披露时间	投资企业	金额	轮次	投资比例	估值
/	2023-01-14	正心谷资本，联和资本，复星创富，湖北科投，诺华资本，君海创芯，峰毅远达基金，复星集团，清石资产管理集团，南钢股份，信科资本，光谷产业投资	未披露	D+轮	/	/
/	2022-06-09	君海创芯，基石资本，海达投资，泰达科投，君桐资本，融沛资本，中信集团，苏州国发创投，中信建投资本，松川科技投资，海风投资	数亿人民币	D轮	/	/
/	2021-09-03	天府集团，凯腾投资	未披露	C轮	/	/
/	2021-06-23	哈勃投资	未披露	B轮	/	/
/	2021-02-05	鹏晨投资，元禾璞华，冯源资本	未披露	A轮	/	/
/	2020-10-26	丰年资本	5000万人民币	天使轮	/	/

公司竞争优势

▪ 竞争优势

强一股份成立于2015年8月，坐落于苏州工业园区，是专注于服务半导体设计与制造的高新技术企业，是聚焦晶圆测试核心硬件探针卡(probecard)的研发、设计、生产与销售为一体的企业。强一股份目前具备探针卡及核心部件的专业设计能力，也是国内少有的可以拥有自主MEMS探针制造技术并能够批量生产、销售MEMS探针卡的厂商。

强一股份官网

② 江苏鹏利芝达恩半导体有限公司

▪ 公司信息

企业状态	存续	注册资本	2000万人民币
企业总部	徐州市	行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
法人	李艳丽	统一社会信用代码	91320321MA7H0CKH4P
企业类型	有限责任公司	成立时间	1643040000000
品牌名称	江苏鹏利芝达恩半导体有限公司	经营范围	一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；电子元器件批发；电子专用设备销售；电子产品销售；电子专用设备制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；塑料制品销售；电子测量仪器销售；合成材料销售；机械设备销售；机械设备研发；仪器仪表销售；橡胶制品销售；金属制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司竞争优势

▪ 竞争优势

江苏鹏利芝达恩半导体有限公司是一家同时掌握悬臂探针卡、MEMS垂直探针卡、RF薄膜探针卡研发能力的中韩合资探针卡生产企业，由探针卡世界排名第六的韩国koreainstrumentco.ltd创始人金秀学在中国创立。公司主营产品有探针卡、垂直探针卡、悬臂探针卡、半导体探针卡、MEMS探针卡等产品，是一家专业的半导体探针卡厂家。

[鹏利芝达恩官网](#)

③ 浙江微针半导体有限公司

▪ 公司信息

企业状态	存续	注册资本	3013.6909万人民币
企业总部	嘉兴市	行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
法人	刘红军	统一社会信用代码	91330421MA2JHDXN4D
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立时间	1622044800000
品牌名称	浙江微针半导体有限公司	经营范围	一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；集成电路制造；集成电路销售；专用设备修理；软件开发；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

▪ 融资信息

融资时间	披露时间	投资企业	金额	轮次	投资比例	估值
/	2024-06-12	金浦投资	未披露	A轮	/	/
/	2024-04-22	海越资管	未披露	Pre-A轮	/	/
/	2021-08-24	海越资管	未披露	天使轮	/	/

公司竞争优势

▪ 竞争优势

浙江微针半导体有限公司于2021年成立，是中国少数纯国产的、能够自主研发和生产MEMS探针卡的公司，拥有完全自主知识产权；始终致力于采用领先的技术造就一流的产品，从细节出发，严格控制原材料、工艺、设备和QC流程。拥有MEMS微悬臂卡、MEMS垂直卡、碳化硅晶圆级老化探针卡、MEMSWAT卡、显示驱动芯片测试探针卡等产品。

[微针半导体官网](#)

附录

法律声明



权利归属：头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。

尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并应提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

内容使用：未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。

合作维权：头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。

成为头豹会员—享专属权益

- 成为头豹会员，尊享头豹海量数据库内容及定制化研究咨询服务
- 头豹已累积上万本行业报告、词条报告，拥有20万+注册用户，沉淀100万+原创数据元素
- 头豹优势：行业覆盖全、数据量庞大、研究内容应用场景广泛，并有专业分析师团队为您提供定制化服务，助力企业展业

报告次卡

任意10本报告
阅读权益（一年有效）

¥598 /年

企业标准版



适用于研究频次高的用户或企业
无限量阅读全站报告
升级报告下载量
专享企业服务
定制词条报告

¥50,000 /年

企业专业版/旗舰版



满足定制研究需求的企业用户
定制深度研究报告
随需下载报告
分析师一对一沟通
专享所有核心功能

¥150,000+ /年

购买与咨询

咨询邮箱：

nancy.wang@frostchi
na.com

客服电话：

400-072-5588